

【11】證書號數：M555554

【45】公告日：中華民國 107 (2018) 年 02 月 11 日

【51】Int. Cl. : H01F27/28 (2006.01)

新型

全 9 頁

【54】名稱：晶片型被動元件

【21】申請案號：106211981 【22】申請日：中華民國 106 (2017) 年 08 月 14 日

【72】新型創作人：張慧文 (TW)

【71】申請人：力全電子科技有限公司

新北市板橋區民族路 289 巷 3 之 3 號

【74】代理人：劉菁茹

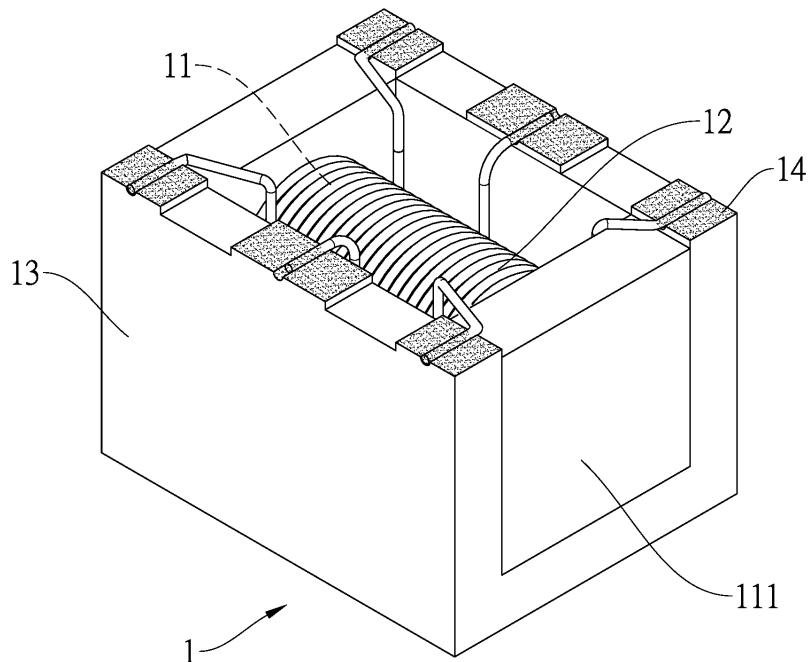
【57】申請專利範圍

- 一種晶片型被動元件，係至少包括有：一基座(11)；至少二線圈(12)，係繞設於該基座(11)之外端部；一磁罩(13)，係罩設於該等線圈(12)之外部並具有一開口(131)；以及至少二銀鉀層(14)，係對應形成於該開口(131)之二側部，其中該線圈(12)係對應與該銀鉀層(14)接觸而形成電性連接。
- 如申請專利範圍第 1 項所述之晶片型被動元件，其中該基座(11)係呈圓柱體或橢圓體其中之一。
- 如申請專利範圍第 2 項所述之晶片型被動元件，其中當該基座(11)呈圓柱體之態樣時，該基座(11)之二末端部係各進一步凸設有一凸緣部(111)。
- 如申請專利範圍第 3 項所述之晶片型被動元件，其中該凸緣部(111)係呈方形或圓形其中之一。
- 如申請專利範圍第 3 或 4 項所述之晶片型被動元件，其中該基座(11)與該凸緣部(111)係由鋅金屬材質所製備而成。
- 如申請專利範圍第 1 項所述之晶片型被動元件，其中該基座(11)外端部係繞設有六個線圈(12)。
- 如申請專利範圍第 1 項所述之晶片型被動元件，其中該等線圈(12)係由銅金屬材質所製備而成。
- 如申請專利範圍第 1 項所述之晶片型被動元件，其中該磁罩(13)係呈口字型、U 字型或袋型其中之一。
- 如申請專利範圍第 8 項所述之晶片型被動元件，其中該磁罩(13)係由鎳金屬材質所製備而成。
- 如申請專利範圍第 3 或 4 項所述之晶片型被動元件，其中該磁罩(13)與該凸緣部(111)之間係進一步塗設有一黏膠層(15)。
- 如申請專利範圍第 1 項所述之晶片型被動元件，其中該銀鉀層(14)係以電鍍方式形成於該開口(131)之二側部。
- 如申請專利範圍第 1 項所述之晶片型被動元件，其中該開口(131)之二側部係形成有六個銀鉀層(14)。
- 如申請專利範圍第 12 項所述之晶片型被動元件，其中該銀鉀層(14)係進一步凹設有一凹槽(141)。

14. 如申請專利範圍第 1 或 13 項所述之晶片型被動元件，其中該線圈(12)係以焊接方式形成於該凹槽(141)。

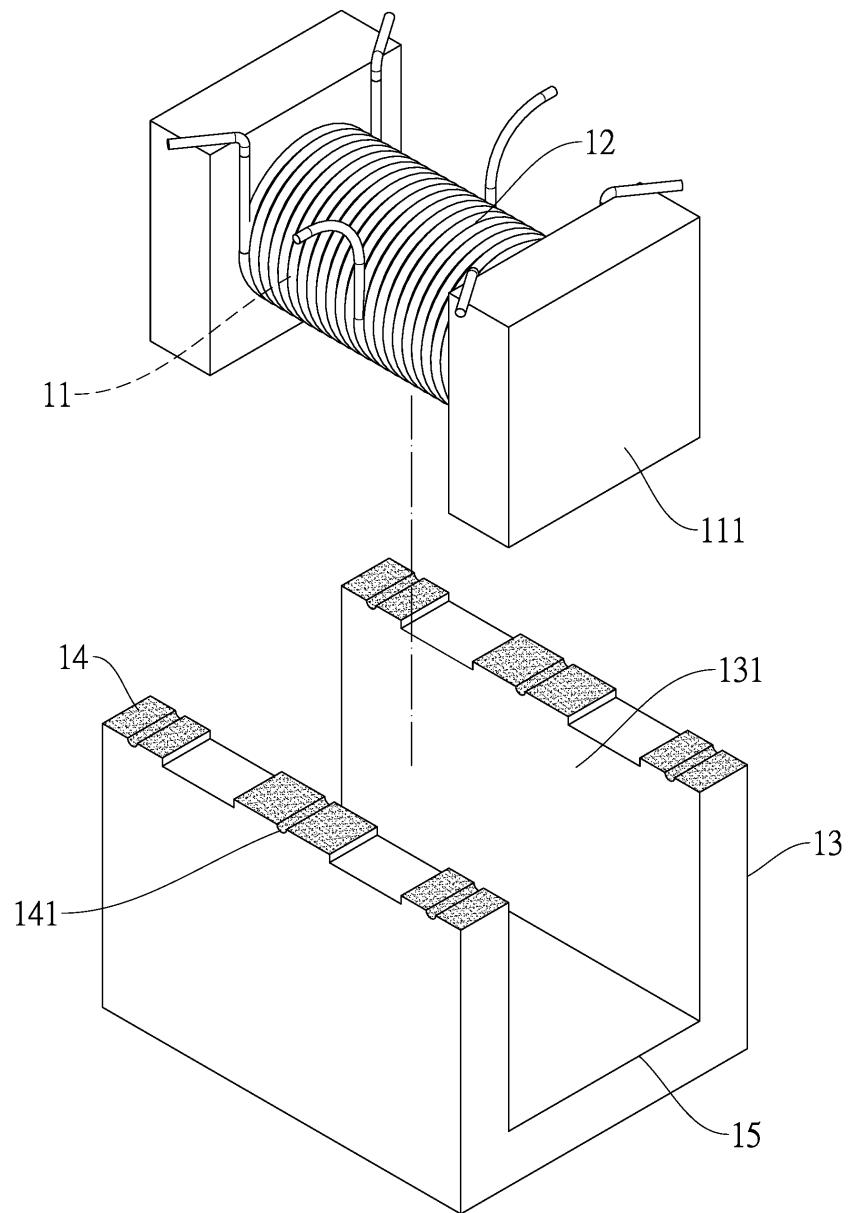
圖式簡單說明

第 1 圖：本創作晶片型被動元件其一較佳實施例之整體裝置立體圖。第 2 圖：本創作晶片型被動元件其一較佳實施例之整體裝置分解圖。第 3 圖：本創作晶片型被動元件其二較佳實施例之整體裝置立體圖。第 4 圖：本創作晶片型被動元件其二較佳實施例之整體裝置分解圖。第 5 圖：本創作晶片型被動元件其三較佳實施例之整體裝置立體圖。第 6 圖：本創作晶片型被動元件其三較佳實施例之整體裝置分解圖。第 7 圖：本創作晶片型被動元件其三較佳實施例之整體裝置分解圖。第 8 圖：本創作晶片型被動元件其四較佳實施例之整體裝置立體圖。



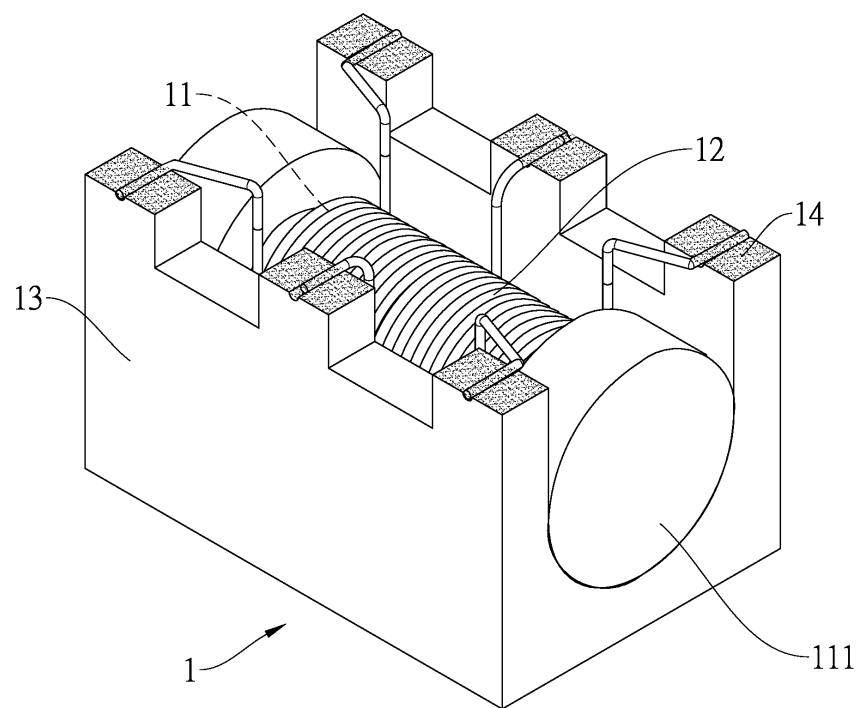
第 1 圖

(3)



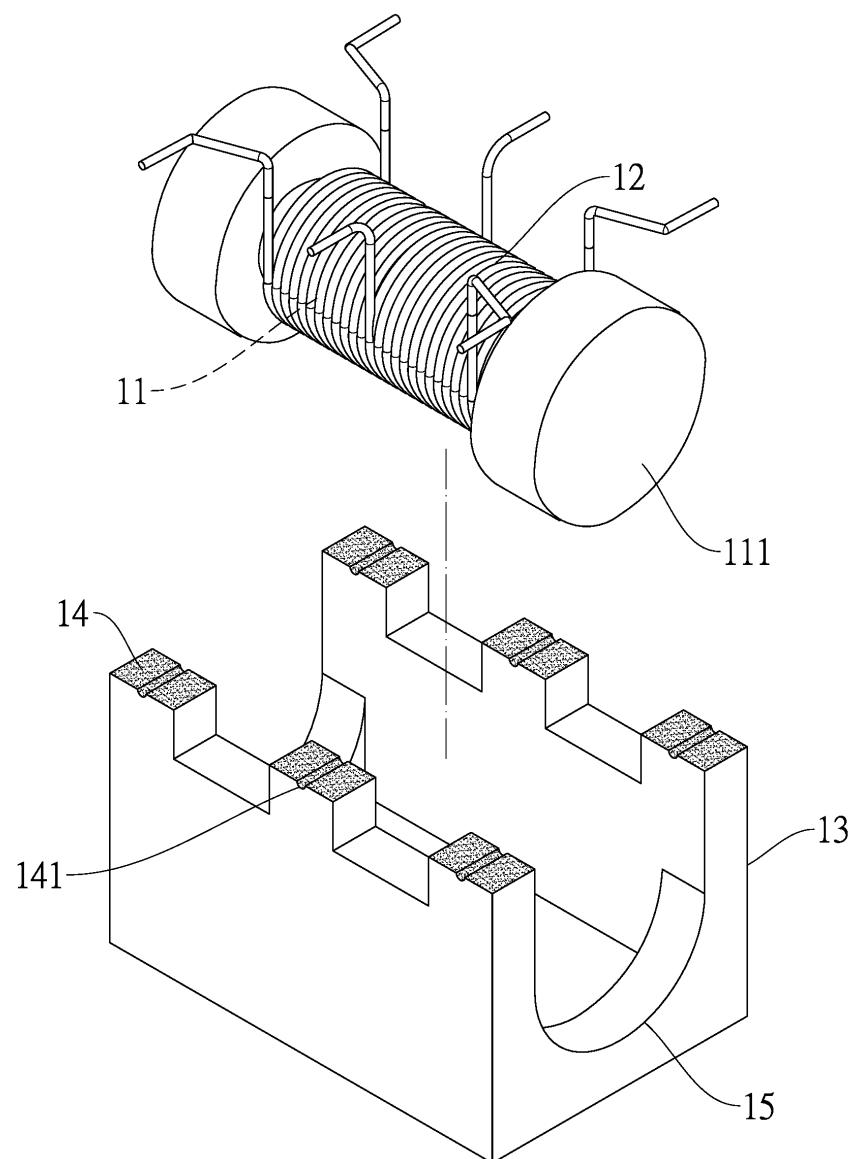
第 2 圖

(4)



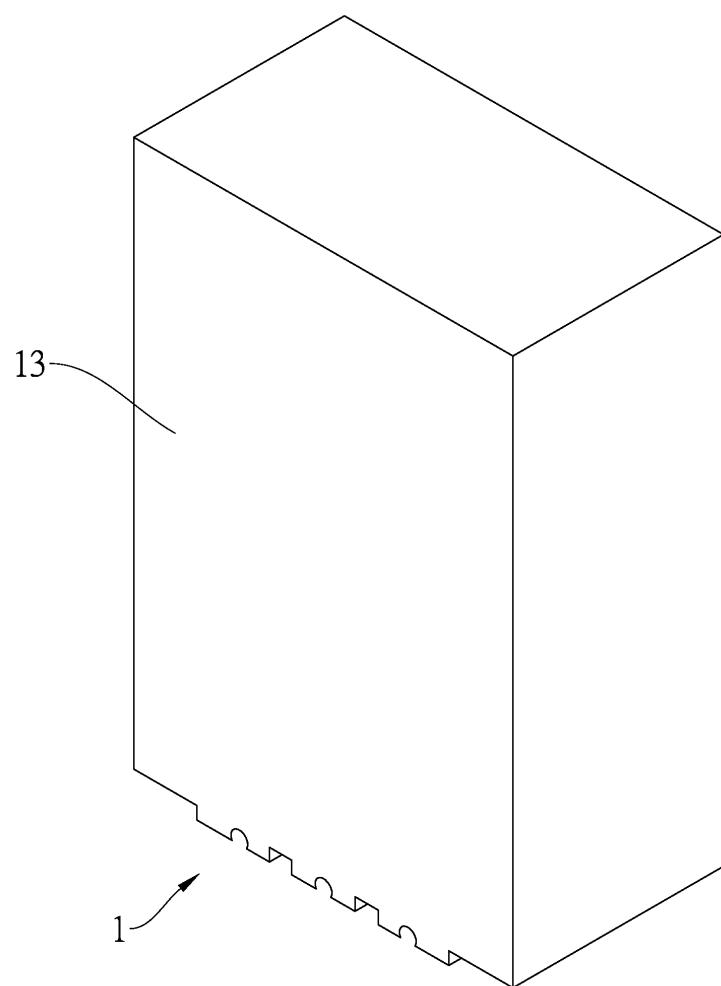
第3圖

(5)

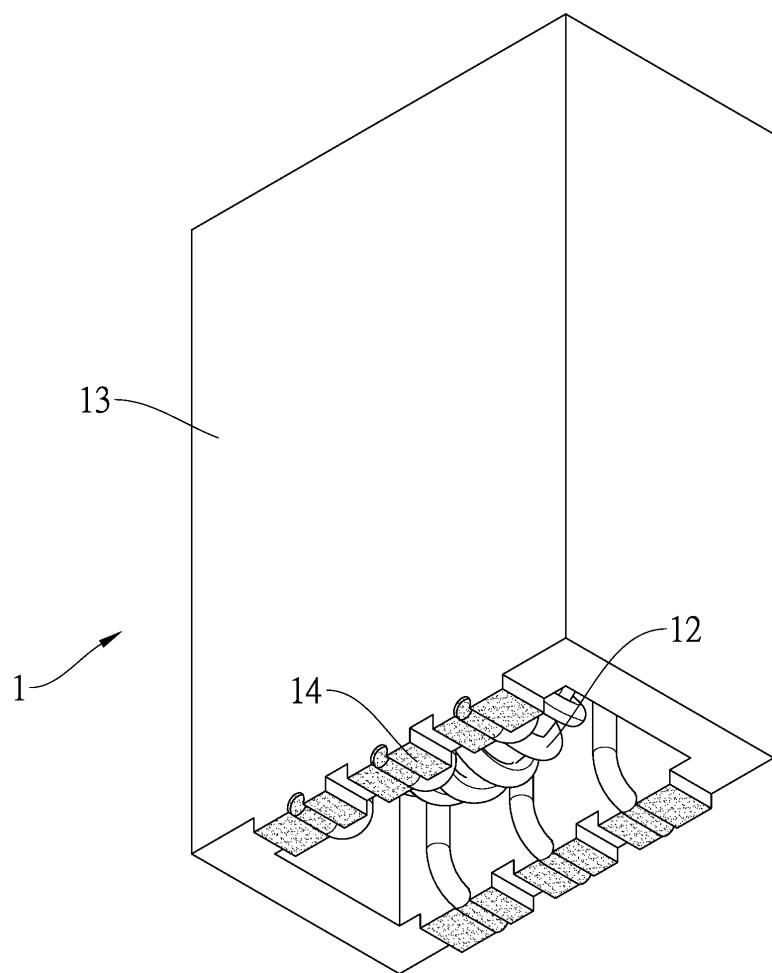


第 4 圖

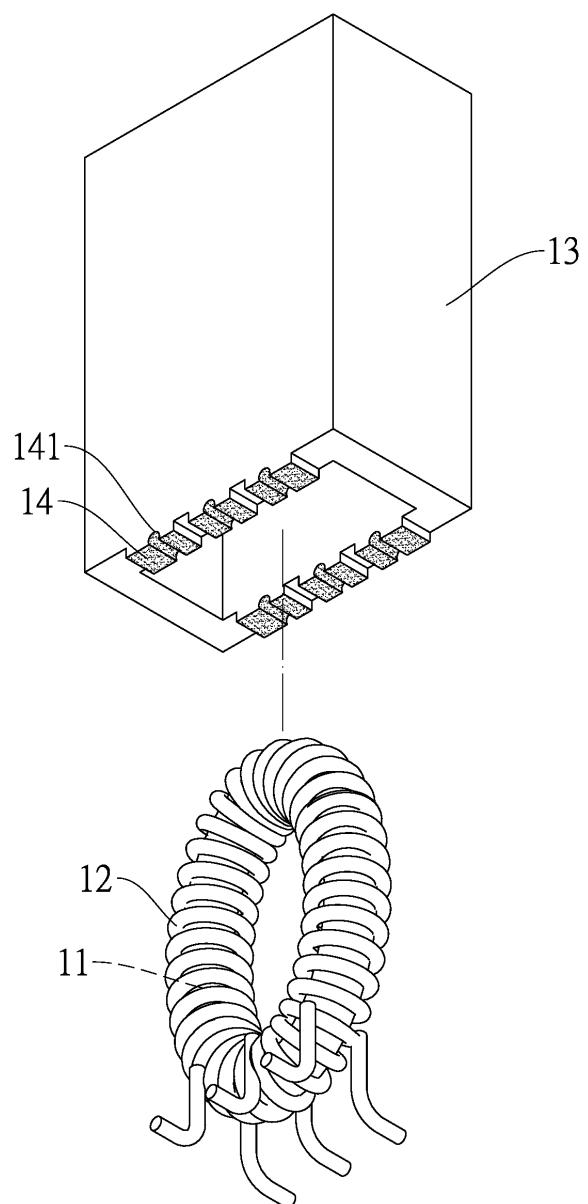
(6)



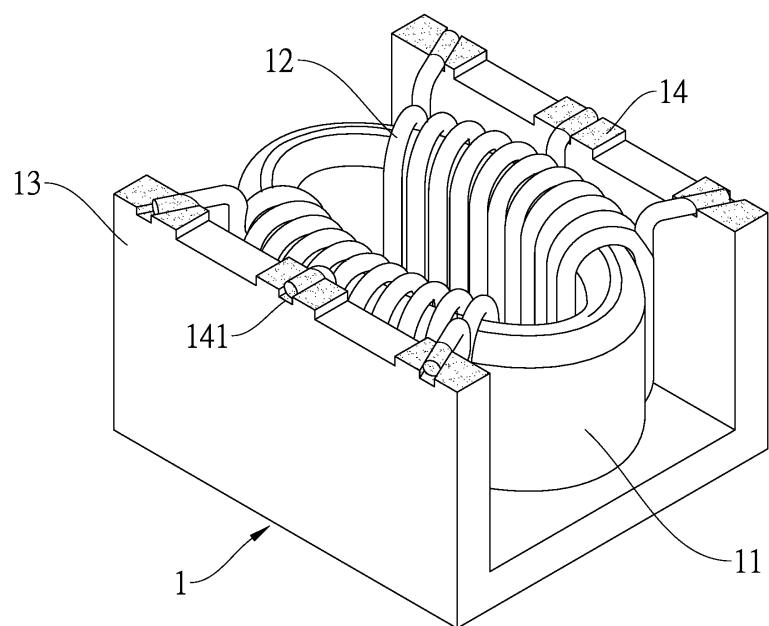
第 5 圖



第 6 圖



第 7 圖



第 8 圖